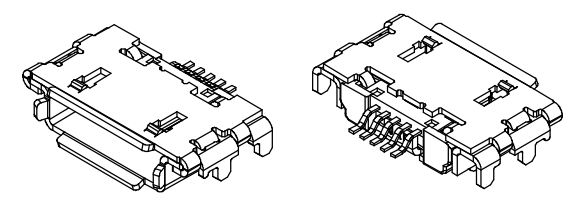
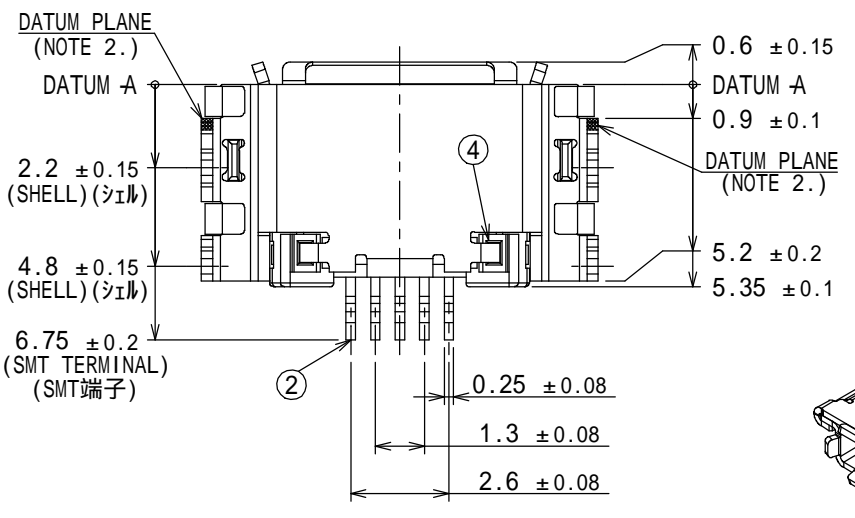
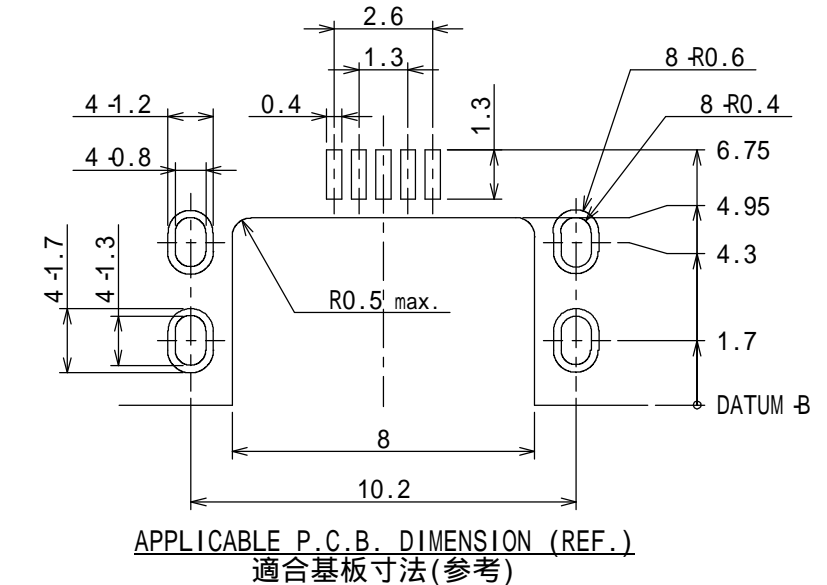
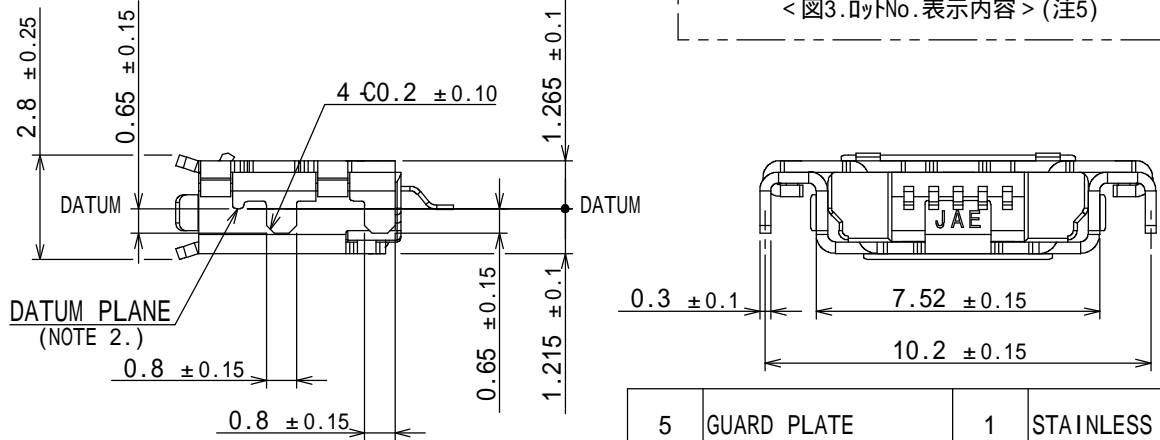
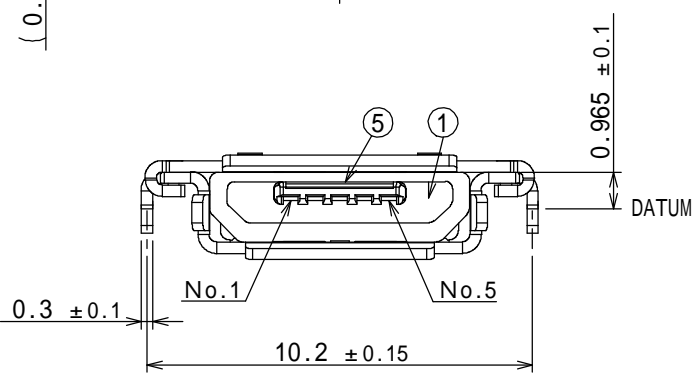
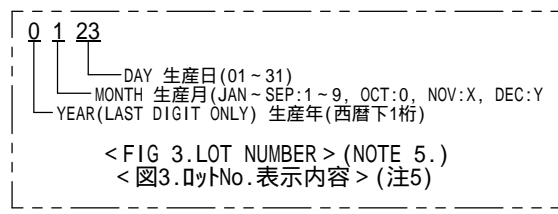
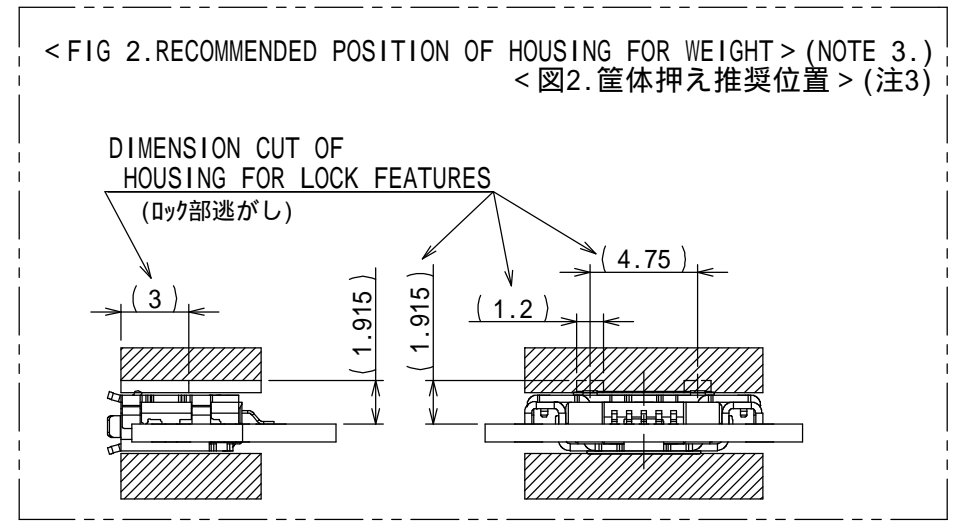
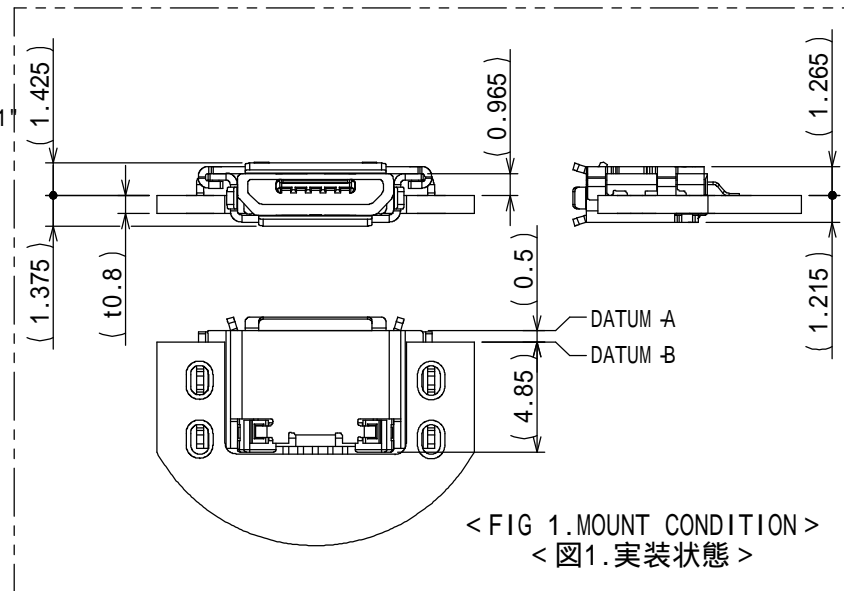
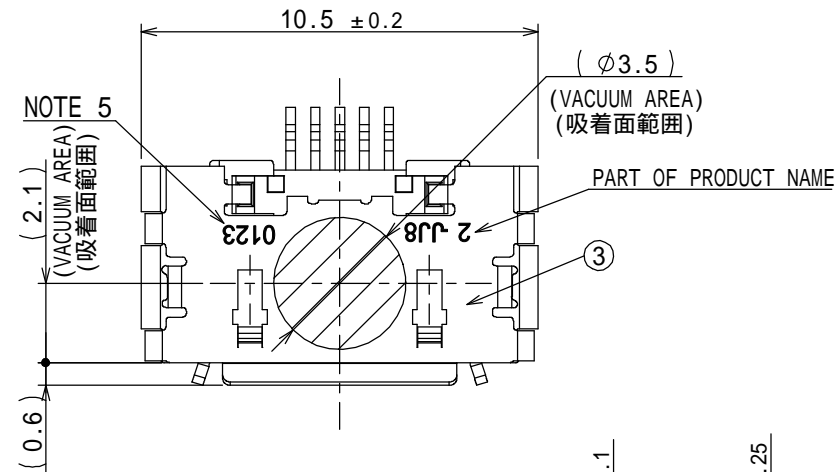


版数 REV.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

NOTE 1. COPLANARITY OF SMT TERMINAL IS 0.08MAX.
 NOTE 2. THIS FACE IS BASE.
 NOTE 3. FOR PREVENTION OF A CHANGE OF A CONNECTOR, PLEASE DO WEIGHT OF HOUSING BY ALL MEANS.
 NOTE 4. THIS CONNECTOR CONSISTS OF
 "Universal Serial Bus Micro-USB Cable and Connector Specification Revision 1.01"
 NOTE 5. MARK LOT NUMBER IN PLACE TO SHOW IN FIGURE. (REFER TO FIG 3)

注1. 本コネクタのSMT端子のバラツキ(1コネクタ内のMAX値とMIN値の差:バラツキ)は0.08以下とする。
 注2. この面は基準面である。
 注3. コネクタの変形防止の為、必ず筐体で抑えること。
 注4. 本コネクタの開口部寸法は、
 "Universal Serial Bus Micro-USB Cable and Connector Specification Revision 1.01"
 による。
 注5. 図示の位置にロットNo.を表示する。(図3参照)



符号 No.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
5	GUARD PLATE	1	STAINLESS STEEL	-	t0.12
4	SHELL2	1	STAINLESS STEEL	TIN OVER NICKEL	t0.3
3	SHELL1	1	STAINLESS STEEL	TIN OVER NICKEL	t0.3
2	CONTACT	5	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD OVER Pd-NI TERMINAL AREA: GOLD FLASH OVER NI	GOLD PLATING: 0.05 μm MIN NI-Pd PLATING: 0.75 μm MIN GOLD FLASH PLATING: 0.08 ~ 0.13 μm
1	INSULATOR	1	9Tny	COLOR: GRAY	UL94 HB

仕様書 (SPECIFICATION) JACS -30258	第1版 (ORIGINAL DATE) 29/FEB/2012	尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) DX4	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	名称 (TITLE) DX4R205JJ8		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
. ± 0.8 .X ± 0.4 .XX ± 0.1 .XXX ±	× ° ± × °' ±	質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ112802
担当者 (DR.) M. NISHIKATA		承認 (APPD.) M. KIKUCHI		版数 (REV.) 1

WISDOM承認 2012/03/05

DCF-C-212G (11.08)

